**PARA DIFUSIÓN INMEDIATA CONTACTO**

Matt Burns

[matthew.burns@samtec.com](mailto:matthew.burns@samtec.com)

812-944-6733

**[SAMTEC LOGO] Septiembre 2017**

**Samtec** **amplía** **su sistema de conectores backplane de alta velocidad ExaMAX® con nuevas opciones DMO (Direct Mate Orthogonal)**

La arquitectura ortogonal aumenta las prestaciones y la eficiencia térmica de SI

**New Albany (Indiana, EE.UU.):** Samtec, fabricante global con ventas anuales de   
662 millones de dólares y una amplia gama de soluciones de interconexión electrónica, anuncia la ampliación del sistema de conectores backplane de alta velocidad ExaMAX® con nuevas opciones DMO. Los diseñadores de sistemas ahora pueden aprovechar las ventajas inherentes de las arquitecturas ortogonales de conexión directa frente a los sistemas backplane tradicionales.

Las nuevas soluciones ExaMAX® DMO de Samtec ofrecen flexibilidad a los diseñadores de sistemas al eliminar la placa intermedia, permitiendo así la conexión directa de tarjetas de conmutación y tarjetas de línea. Esta arquitectura del sistema, de rápido crecimiento, aumenta el caudal de aire y mejora la eficiencia térmica en todo el chasis. Las soluciones DMO mejoran la integridad de señal mediante longitudes más cortas de la pista y menos transiciones del conector, además de simplificar la lista de materiales del sistema y optimizar su coste.

El sistema ExaMAX® DMO de Samtec está formado por la nueva serie [EBDM-RA](https://www.samtec.com/products/ebdm-ra), que se conecta directamente a la serie [EBTF-RA](https://www.samtec.com/products/ebtf-ra) existente. En la actualidad hay disponibles soluciones de 6 pares x 10 columnas y 6 pares x 12 columnas, así como opciones para montaje con guía y atornillado. Las opciones de 6 pares x 6 columnas y 6 pares x 8 columnas se encuentran en fase de desarrollo.

“Los diseñadores de sistemas de próxima generación están desarrollando arquitecturas DMO con rapidez”, señaló Jonathan Sprigler, Product Manager de Backplanes de Samtec, Inc. “Los principales suministradores de equipos en todo el sector de centros de datos – almacenamiento, servidores, redes y otras aplicaciones – aprovechan las ventajas de DMO gracias a la nueva serie EBDM-RA de Samtec”.

La serie [EBDM-RA](https://www.samtec.com/products/ebdm-ra) de Samtec es tan solo una solución del sistema de conectores backplane de alta velocidad ExaMAX®. La línea de productos ExaMAX® está optimizada para velocidades de hasta 56 Gbps (modulación PAM-4). La conformidad de las pérdidas de retorno se logra en sistemas de 85 Ω y 100 Ω gracias al cumplimiento de las especificaciones de 92 Ω y al control de las reflexiones en todas las transiciones de la geometría dentro del conector.

ExaMAX® también se caracteriza por la fuerza de acoplamiento más baja del mercado, con una excelente fuerza normal, y cumple las especificaciones Telcordia GR-1217 CORE. Con dos puntos fiables de contacto en todo momento, incluso cuando se someten a una conexión en ángulo, se minimizan los contactos residuales para mejorar la integridad de señal. Un deslizamiento del contacto de 2,4 mm aumenta la fiabilidad, mientras que el interface hermafrodita asegura una conexión perfecta y una alineación fiable.

El sistema backplane está formado por obleas de señal individuales con pares diferenciales en un diseño escalonado y configurado en columnas sin inclinación. Cada oblea incluye una estructura de tierra en relieve de una sola pieza que aumenta el aislamiento para reducir la diafonía de forma significativa.

Para más información, vea el seminario web “[High-Speed Backplane Connectors Drive 56 Gbps and Beyond](http://www.eejournal.com/chalk_talks/high-speed-backplane-connectors-drive-56-gbps-and-beyond/)”, visite la web del [sistema de conectores backplane de alta velocidad ExaMAX®](https://www.samtec.com/connectors/backplane/high-speed-backplane-systems/examax) o descargue la [guía de diseño de aplicaciones tarjeta-tarjeta de alta velocidad](http://suddendocs.samtec.com/literature/samtec-high-speed-b2b-design-guide.pdf). El soporte técnico inmediato está disponible mediante los expertos en aplicaciones de backplane de Samtec en [HSBP@samtec.com](mailto:HSBP@samtec.com).

**Acerca de Samtec, Inc.**

Samtec fue fundada en 1976 y es un fabricante global con una amplia línea de soluciones de interconexión electrónica y una facturación de 662 millones de dólares. Entre sus productos se encuentran soluciones de CI a placa y de encapsulado de CI, de placa a placa a alta velocidad, cables de alta velocidad, interconexiones ópticas para placas intermedias y paneles, apilamiento flexible, y componentes y cables micro/robustos. Los centros tecnológicos de Samtec se dedican al desarrollo de tecnologías avanzadas, estrategias y productos que optimizan las prestaciones y el coste de un sistema desde la pastilla de semiconductor sin encapsular hasta un interface situado a 100 metros, y con todos los puntos de interconexión situados entre medio. Con sus 33 sedes en 18 países, la presencia mundial de Samtec le permite ofrecer un servicio al cliente incomparable. Para más información, visite <http://www.samtec.com>.

ExaMAX® es una marca registrada de Amphenol Corporation.

**Samtec, Inc.**

**P.O. Box 1147**

**New Albany, IN 47151-1147**

**USA**

**Tel.: 1-800-SAMTEC-9 (800-726-8329)**

[www.samtec.com](http://www.samtec.com)